

集成电路工艺基础



作者：王阳元等编著

出版社：北京：高等教育出版社

出版日期：1991.05

总页数：610

介绍：本书主要内容有：硅晶体结构，扩散、离子注入、外延、氧化、化学汽相淀积、光刻、刻蚀等十二章。

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10816942.html>）查找全本阅读方式

集成电路工艺基础 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10816942.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10816942.html>

书名：集成电路工艺基础